

---

MAKING THE IMAGE INTELLIGENT

---



# 事業計画及び成長可能性に関する事項

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル

2025年6月23日

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

- 会社概要
- ビジネスモデルと競争優位性
  - ビジネスモデル・収益サイクル
  - 競争優位性
  - 収益構造
- 市場動向
- 成長戦略・事業戦略
- リスク情報
- 本資料の取り扱いについて
- 補足資料





# 会社概要



創業以来、世界有数のGPU IPベンダーとして実績を誇るファブレス半導体ベンダーです。近年は世界をリードする「AI Computing Company」となるべく、アルゴリズム・ソフトウェアからハードウェア、エッジからクラウドに亘るEnd to EndのAIサービスの提供により、お客様や社会の課題解決に貢献しています。

会社名	株式会社デジタルメディアプロフェッショナル (DMP)
事業内容	GPU及びAIに関わる、IPライセンス、SoC/モジュール開発&販売、及び受託開発サービス
設立	2002年7月
所在地	東京都中野区
代表者	代表取締役会長兼社長CEO 山本 達夫
資本金	1,838百万円
連結従業員数	60名 (2025年4月1日現在)
特許数	35件
連結子会社	Digital Media Professionals Vietnam Company Limited

年月	沿革
2002年7月	設立
2005年7月	ULTRAY® ビジュアルプロセッサを発表
2007年4月	PICA®グラフィックスIPコアが「第9回 LSI IPデザインアワード」企業部門「IP優秀賞」を受賞
2009年4月	SMAPH®-FベクターグラフィックスIPコアを発表
2009年11月	SMAPH®-S 3DグラフィックスIPコアを発表
2011年6月	東京証券取引所マザーズ市場へ上場
2014年5月	株式会社UKCホールディングス(現株式会社レスター)と業務資本提携
2016年8月	新3DグラフィックスIPコア「M3000」シリーズを発表
2016年11月	Deep Learningを用いた画像認識エンジン「ZIA™」を発表
2018年3月	次世代グラフィックスプロセッサ「RS1」を量産・出荷開始
2019年5月	ヤマハ発動機株式会社と業務資本提携
2019年5月	ISO9001:2015認証(審査機関インターテック・サーティフィケーション株式会社)取得
2020年4月	「Digital Media Professionals Vietnam Company Limited」を設立
2021年4月	米国Cambrian Inc.と資本業務提携
2022年4月	東京証券取引所グロース市場へ移行
2025年2月	次世代エッジAI半導体事業開始を発表
2025年4月	中国ロボティクス企業3社と販売代理店契約を締結

# 事業内容／取り組み分野と売上高・構成比（2025年3月期）

## ● 事業

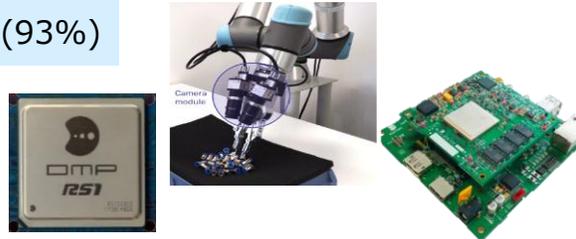
IPコアライセンス事業 124百万円 (4%)

- ・AI/GPU IPコアライセンス
- ・AIソフトウェアライセンス
- ・AI/GPU IPメンテナンス・サポート



製品事業 2,855百万円 (93%)

- ・アミューズメント市場向け画像処理半導体
- ・AI FPGAモジュール
- ・協働ロボット向けビジョンシステム



プロフェッショナルサービス事業 97百万円 (3%)

- ・AIアルゴリズム、コンピュータビジョンソフトウェア受託開発
- ・FPGA/ボード受託開発
- ・安全運転支援システム、ロボティクスに係る顧客製品・サービス開発サポート



## ● 分野

セーフティ分野 38百万円 (1%)

- ・ドライブレコーダー等を活用した先進運転支援システム、ドライバーモニタリングシステム向けAIライセンス、製品、プロフェッショナルサービスの提供



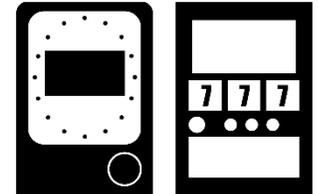
ロボティクス分野 168百万円 (5%)

- ・ロボティクス製品（自律走行ロボット、協働ロボット）向けAIライセンス、製品、プロフェッショナルサービスの提供



アミューズメント分野 2,779百万円 (90%)

- ・アミューズメント市場（遊技機）向け製品、サポートの提供



その他分野 90百万円 (3%)

- ・デジタル機器等向けIPコアライセンス（初期ライセンス、ランニングロイヤリティ）提供
- ・GPU IPメンテナンス・サポート

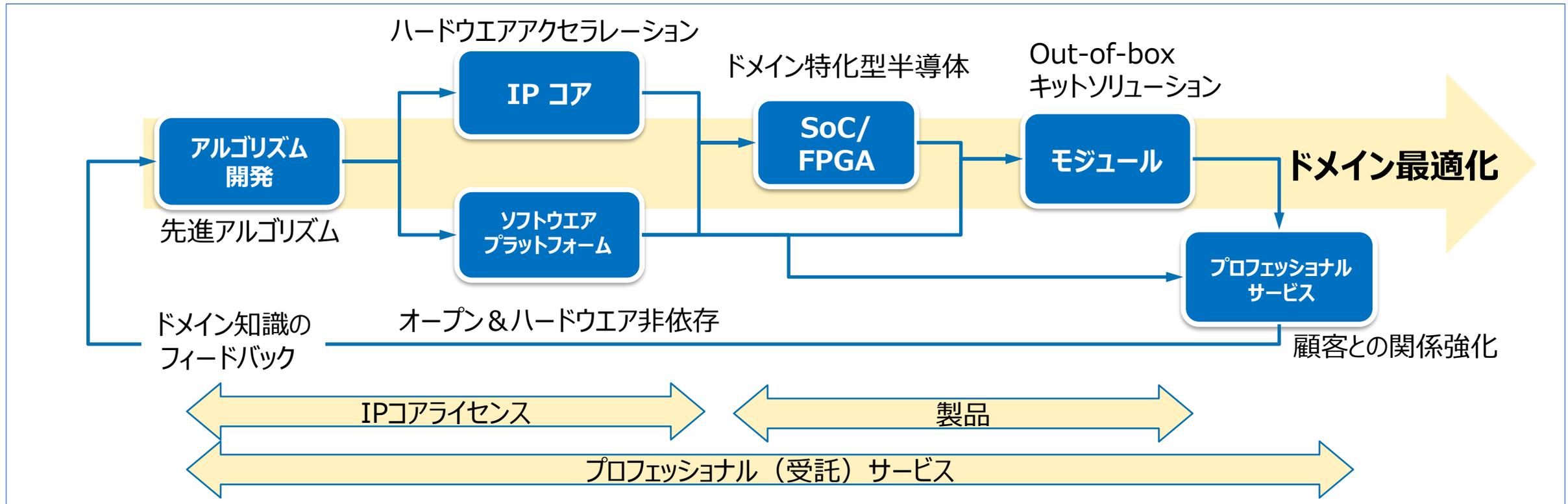




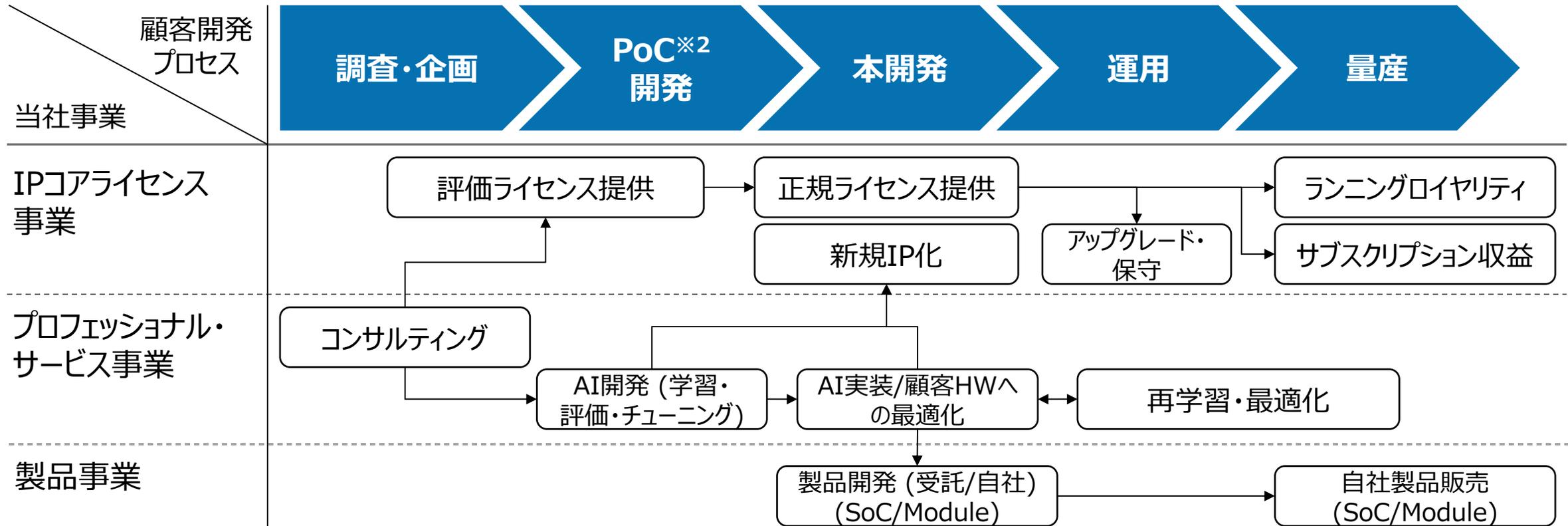
# ビジネスモデルと競争優位性



- アルゴリズム、ソフトウェア、ハードウェアを統合的に開発（ドメイン最適化）
- ライセンス、製品、プロフェッショナルサービスによる柔軟な価値の提供、収益化モデル
- 収益性の高い「IPコアライセンス」、スケール追求型の「プロフェッショナルサービス」、「製品事業」のバランスのとれた収益構造を構築



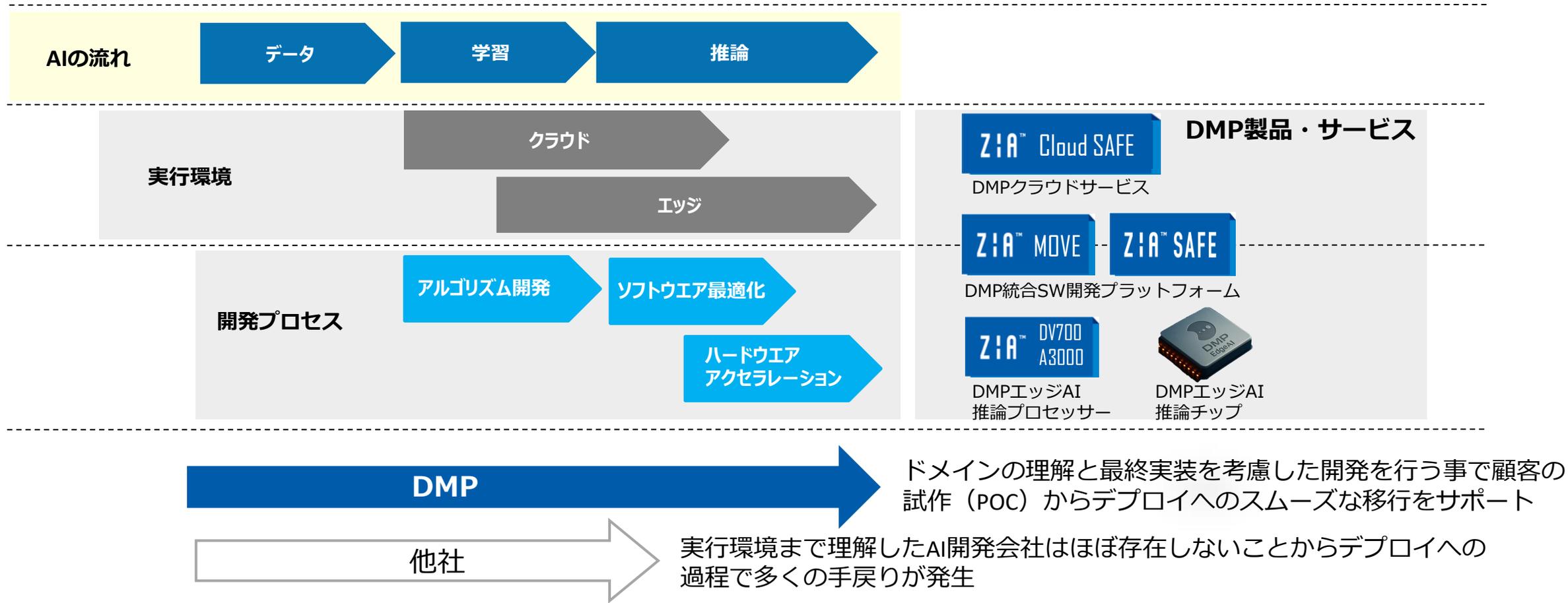
- 顧客製品の開発ライフサイクル全体（企画～量産）に亘る、付加価値提供、LTV※1最大化
- 顧客プロジェクトで培ったテクノロジー・ノウハウに基づく標準製品・サービスの開発・提供により、顧客開発に柔軟、迅速に対応するとともに、利益率の向上を図る



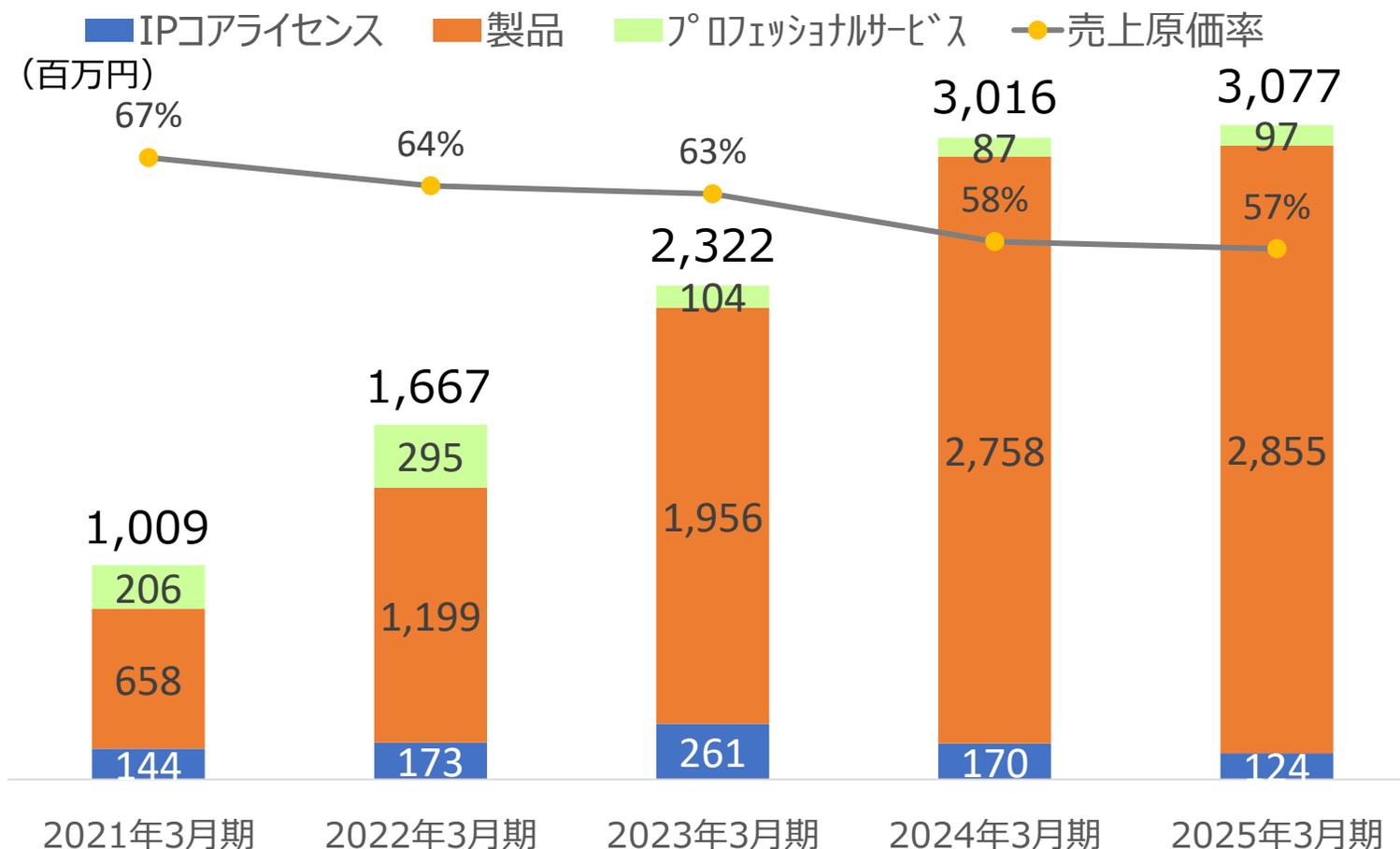
※1 LTV : Lifetime Valueの略。顧客との取引開始から終了までに得られる利益のこと (顧客生涯価値)

※2 PoC : Proof of Conceptの略。新しい概念や理論、原理を本格的に導入する前に行う実現可能性に関する検証・試行のこと

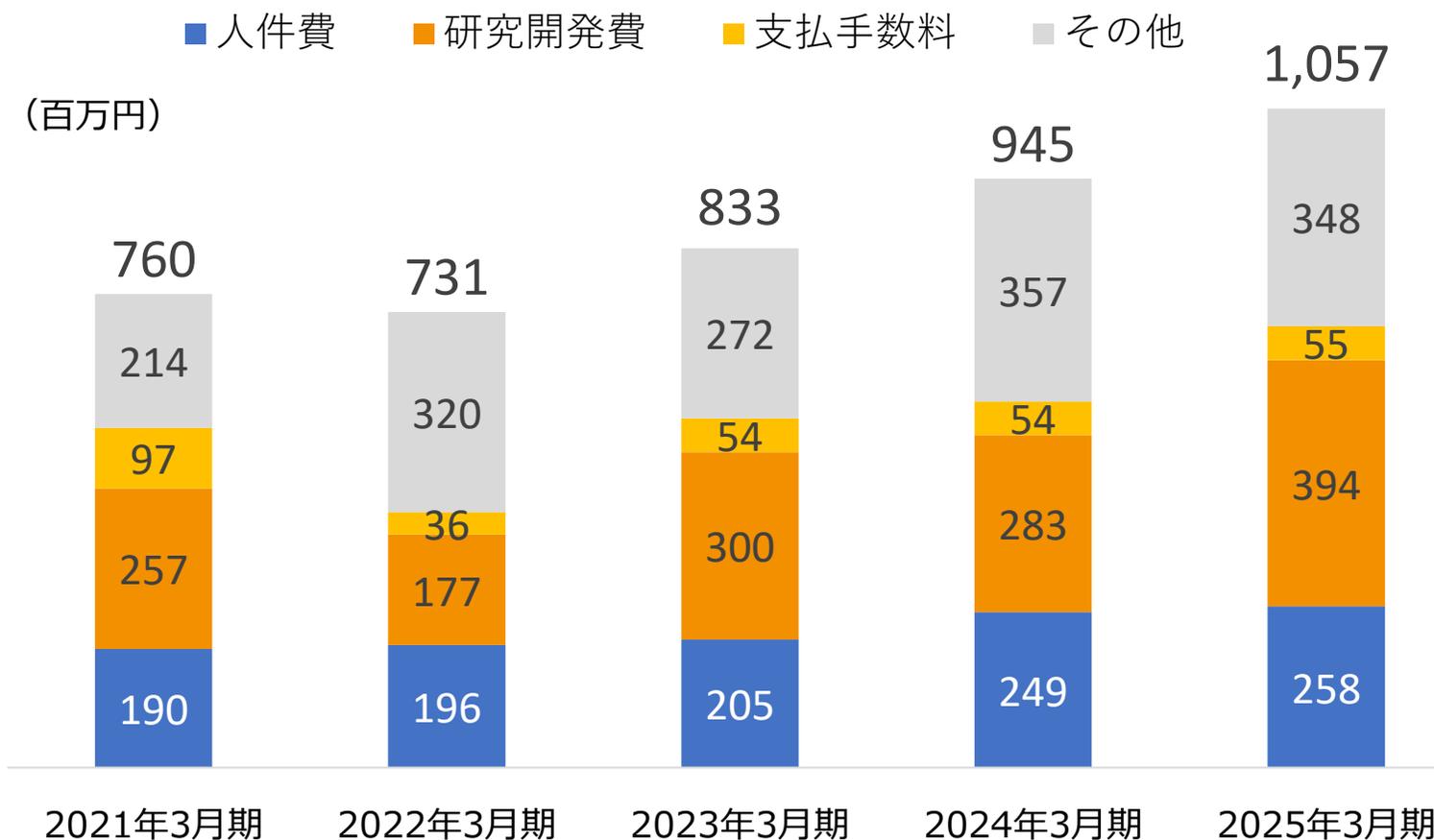
DMPはAI処理をハードウェアを含めてドメインに最適化することが可能



- 売上原価率は、IPコアライセンス売上高(比率)の増加に伴い下降傾向
- 2024年3月期、2025年3月期は製品事業の原価低減により、全体の原価率も低下



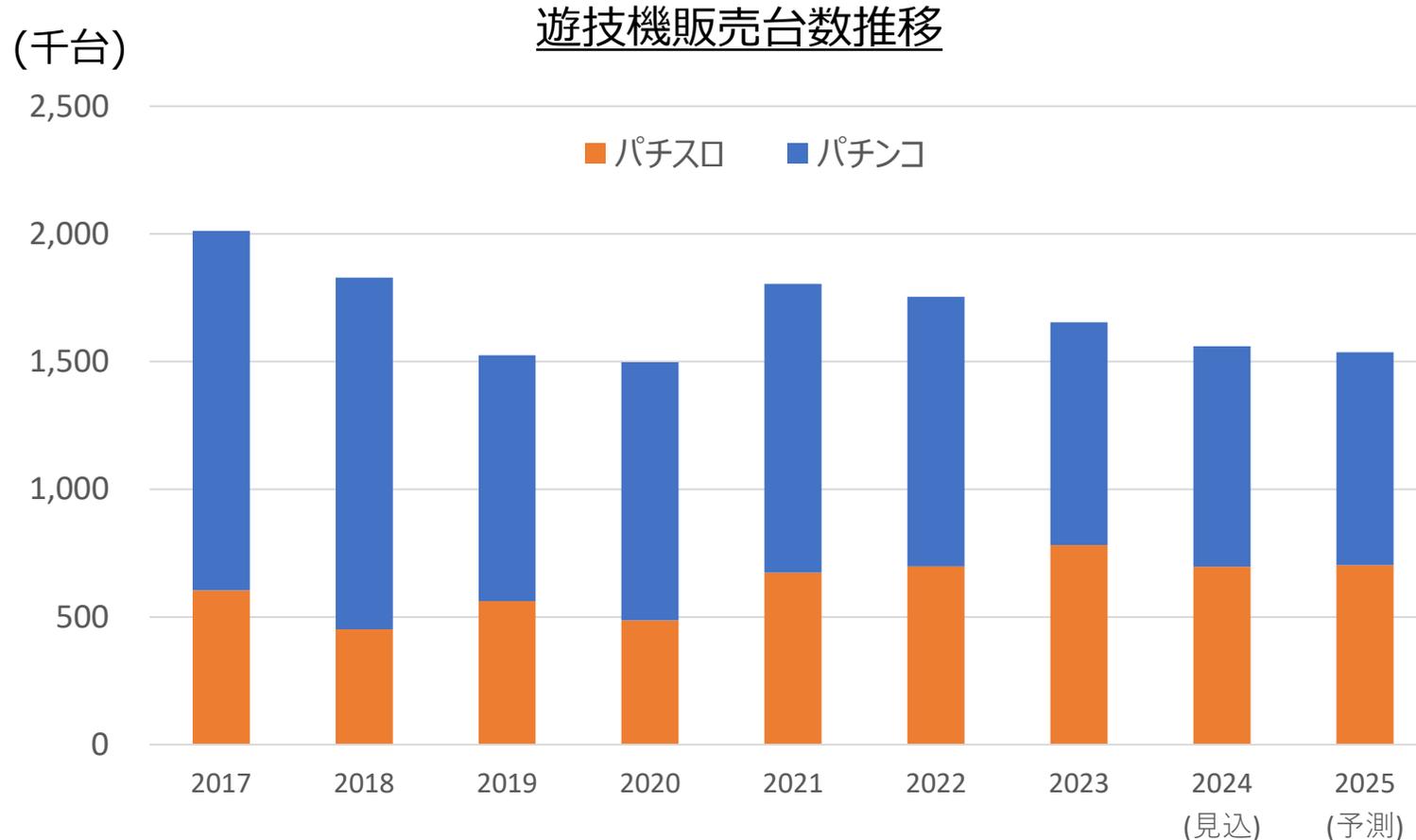
- SGA（販売費及び一般管理費）は人件費や研究開発費が中心
- 研究開発費は、中期的な成長に向けたテクノロジー、ソリューション開発に関わるもの。2025年3月期はエッジAI半導体の開発費により増加



# 市場動向



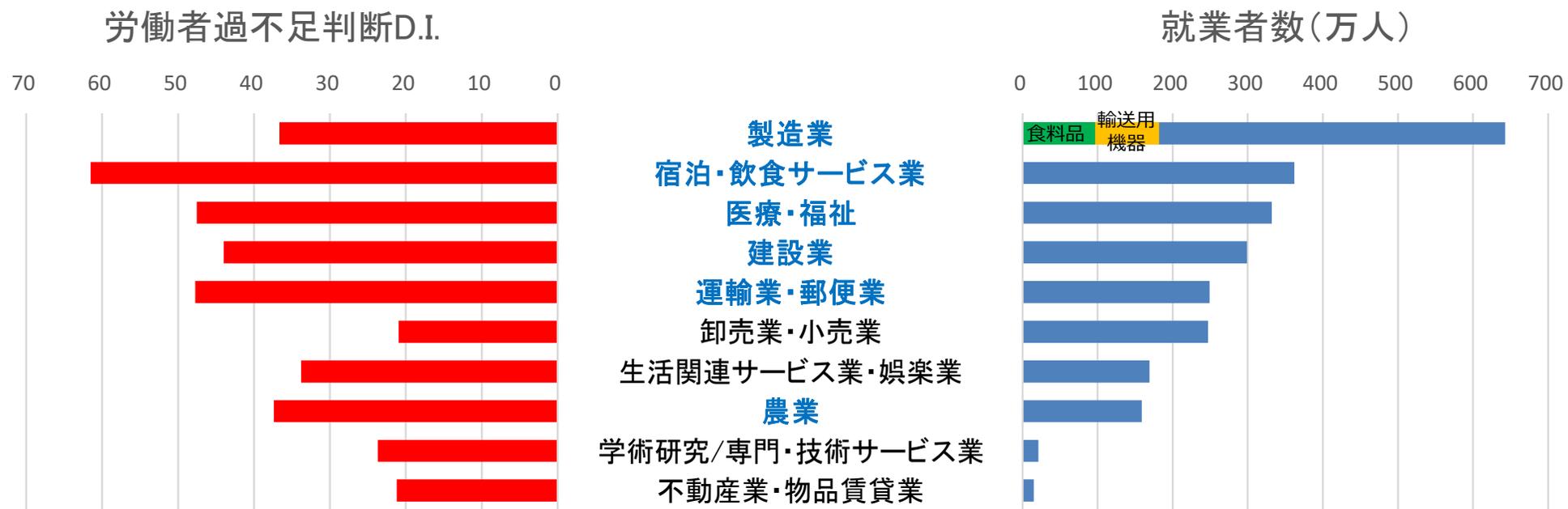
- 当社主戦場のパチスロ市場は2018-2020年度を底に上昇に転じる
- 2025年度もスマートパチスロ、6.5号機中心にパチスロの市場は堅調



出典：矢野経済研究所、見込・予測は遊技機メーカー3社（セガサミーホールディングス、SANKYO、平和）の2025年3月期決算説明資料に記載されている見込・予測数値の平均

労働人口、労働力不足度合の観点から、ロボットの導入効果が期待できる産業は、第一に製造業（就業者が多い順に食料品、輸送用機器）、他に建設業、運輸業、農業に加え、サービス業の宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉も有力

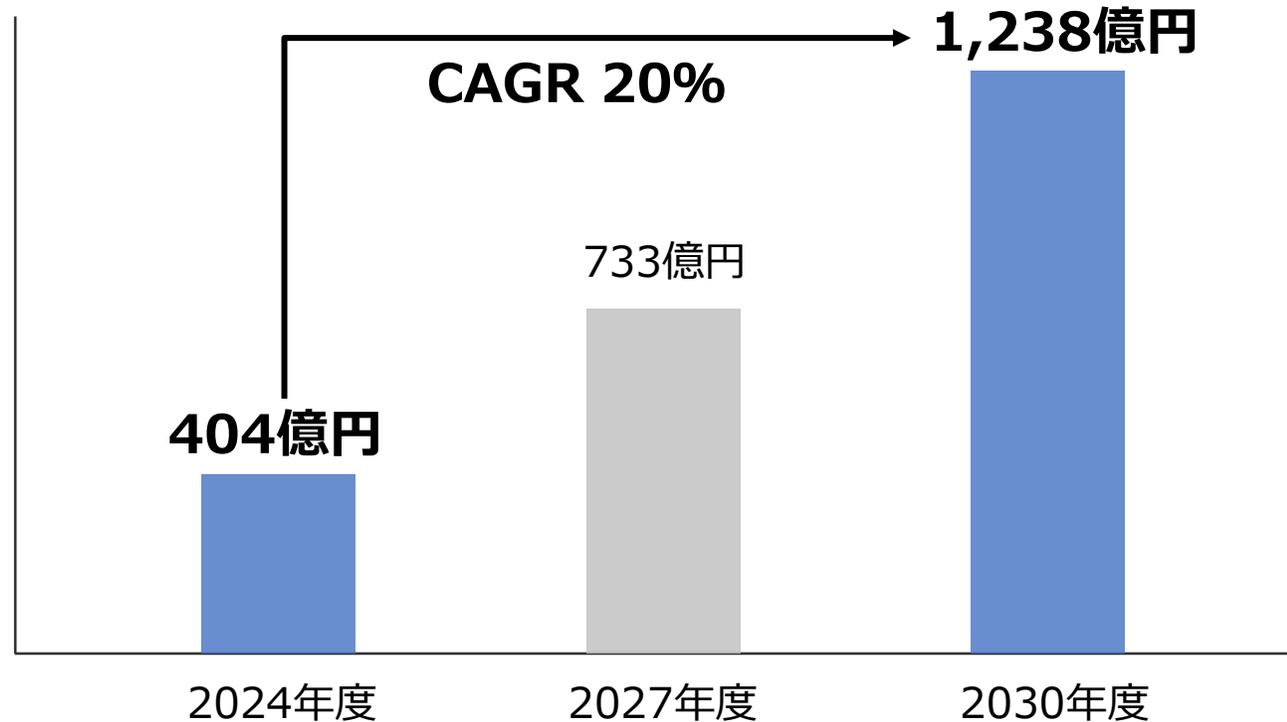
産業別 労働人口／労働力過不足度合



出典  
 就業者数：2025年3月労働力調査結果（総務省統計局）の産業・職業別就業者の内、ロボット導入効果が高いと推測される職業である農林漁業従事者、生産工程従事者、輸送・機械運転従事者、建設・採掘従事者、運搬・清掃・包装等従事者、サービス職業従事者（宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉、生活関連サービス業・娯楽業）の数を弊社が集計したもの  
 労働者過不足判断D.I.：2025年3月労働経済動向調査（厚生労働省）より、輸送・機械運転、技能工、単純工、サービス（宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉、生活関連サービス業・娯楽業）の労働者過不足判断D.I.（不足－過剰）を上記職業別従事者数で弊社が加重平均したもの（農業に関しては、2025年1月農業景況調査（日本政策金融公庫）中の雇用状況DIを使用）

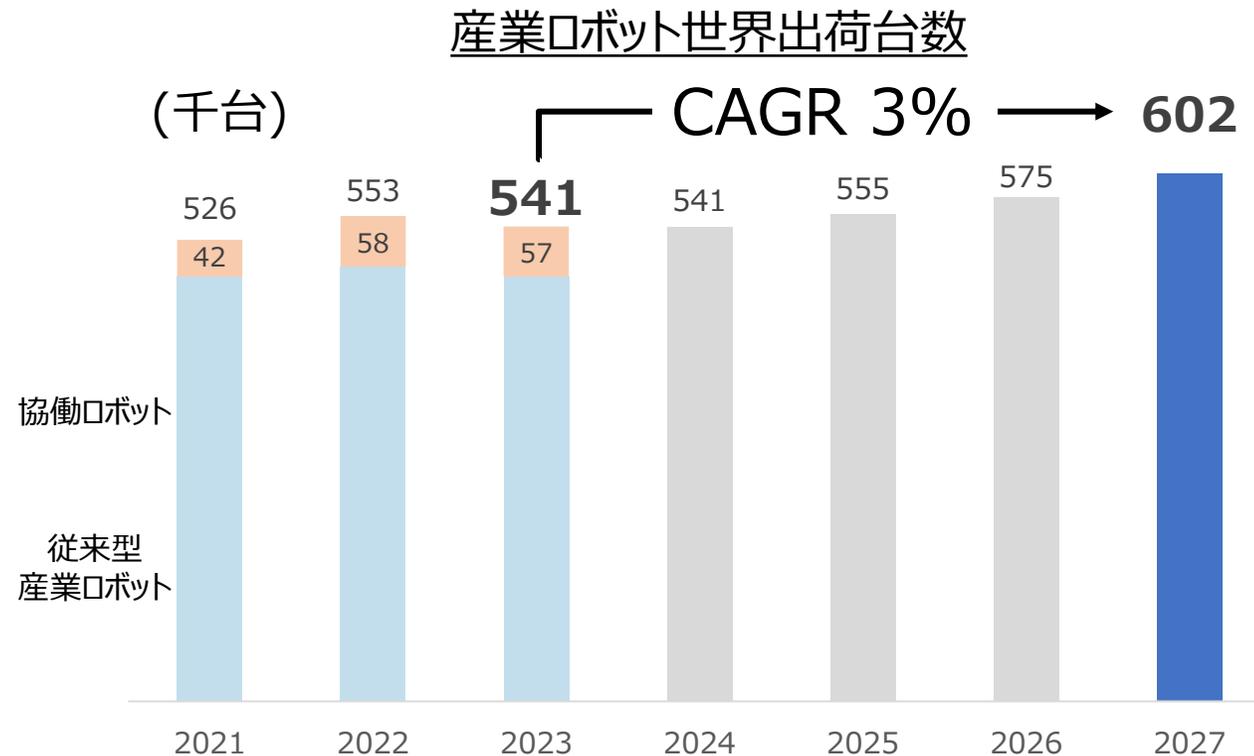
労働人口の減少を受けて、物流ロボットの活用を前提とした物流センター・物流倉庫の構築が進み、ロボット導入率が向上していく見込

## 日本の物流ロボティクス市場規模推移・予測



出典：矢野経済研究所「物流ロボティクス市場の現状と将来展望」2025年2月

- 協働ロボットは、労働人口不足を背景に製造・物流現場での導入が進み、三品産業（食品・医薬品・化粧品）への適用も進む
- 従来型産業ロボットと協働ロボットとの境界線が曖昧に。カメラで物体を検出・認識するAIビジョンシステムの適用範囲も拡大



出典：2024年10月「World Robotics 2024」(国際ロボット連盟(IFR))



# 成長戦略・事業戦略



## Making the Image Intelligent

画像を智能化する

画像インテリジェンスの力で現実世界の問題を解決し、ステークホルダーに価値をもたらす革新的な製品とサービスを創造する

To develop cutting-edge products and services that leverage image intelligence to address practical challenges and deliver value to our stakeholders.

## パーパスを起点としたサステナビリティの取組み

パーパス

"Making the Image Intelligent"  
画像インテリジェンスの力で現実世界の問題を解決し、ステークホルダーに価値をもたらす革新的な製品とサービスを創造する

中長期的な  
持続可能性の視点

社会課題  
・労働人口減克服  
・安心安全社会の実現  
・低炭素社会の実現

当社課題  
セーフティ分野、ロボティクス分野、  
IPコアライセンス事業における  
収益・利益の拡大

サステナビリティのマテリアリティ（重要課題）の特定

事業活動を通じた持続可能な社会の実現

人的資本の視点

人的資本のアライメントと充実

### KPI

- セーフティ分野、ロボティクス分野、その他分野（デジタル機器向けIPライセンス）売上高
- 従業員エンゲージメント指標

## メガトピック

## 社会・環境変化/課題

## DMPの取り組み

### 少子高齢化

- ・労働人口減少
- ・エッセンシャルワーカー労働過多
- ・技能継承問題
- ・高齢者自動車事故増
- ・交通弱者の存在
- ・インフラ老朽化

### 気候変動

- ・温室効果による平均気温の上昇
- ・自然災害の増加
- ・農業生産量・食糧減

- ・ロボティクス領域における自動・自律化の取り組みにより、労働人口減少、過酷労働を補完する生産性の向上・業務効率化、省人化・省力化に貢献
- ・安全運転支援サービスの提供により、リアルタイムの事故防止やヒヤリハット事象に基づく安全運転教育に貢献
- ・自動・自律運転技術により、MaaS推進に貢献
- ・ハードウェア（IP）の低消費電力化により、グローバルな低炭素社会化に貢献
- ・AI画像認識技術を活用し、インフラ検査に貢献

## SDGsへの貢献



強みである共通技術基盤を生かせる分野に注力

## アミューズメント



アミューズメントSoC RS1  
画像モジュール

## ロボティクス



AI推論プロセッサ-IP  
エッジAI推論チップ  
カメラIP (ISP&Stereo)  
GPU IP  
カメラモジュール

自律運転技術  
Visual SLAM  
ピッキングシステム

## セーフティ



安全運転支援システム  
DMS/ ADAS  
クラウドサービス

共通技術基盤

GPU

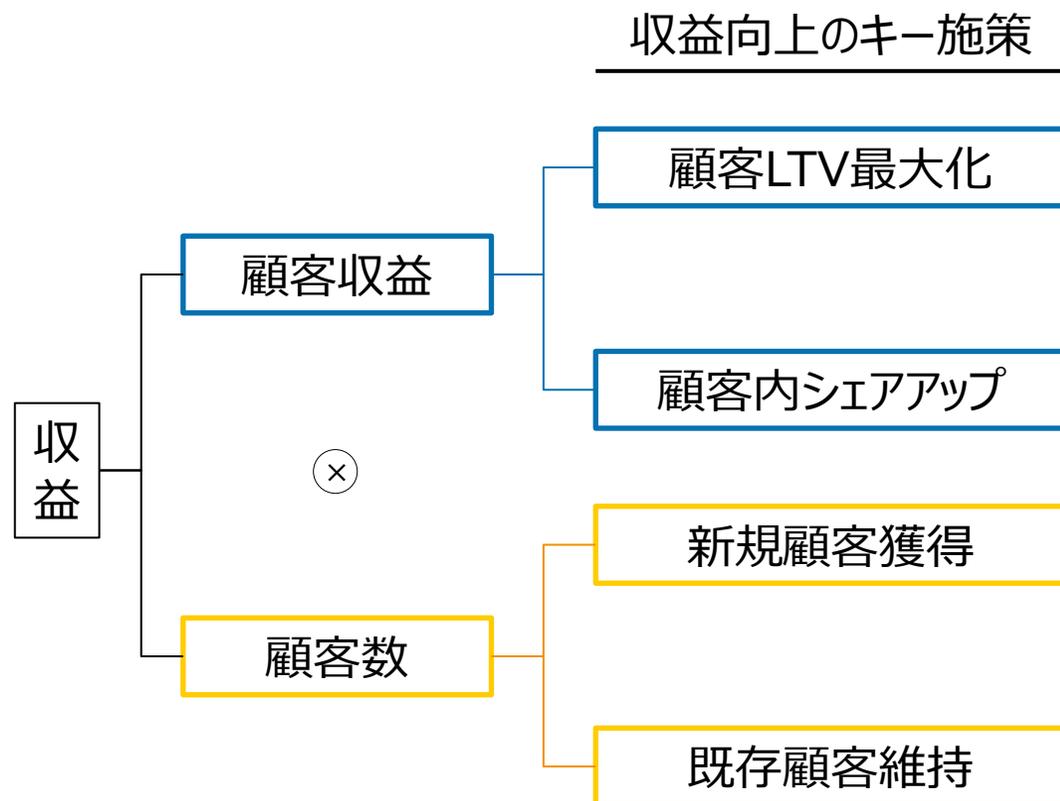
省電力 IP

コンピュータ  
ビジョン

エッジ&クラウド  
コンピューティング



テクノロジーイノベーション、顧客/エコシステムマネジメント、オペレーションマネジメントにより収益を最大化



## 収益向上のキー施策

## 収益向上のキーアクティビティ

### 1. テクノロジーイノベーション

テクノロジー/製品/サービスの改良、ラインアップ拡大により顧客LTVの最大化、顧客内シェアアップ、顧客維持・獲得を図る

### 2. 顧客/エコシステムマネジメント

顧客を含めた各種エコシステムとの関係性向上や協業活性化により、顧客維持・獲得、テクノロジーの補完を図る

### 3. オペレーションマネジメント

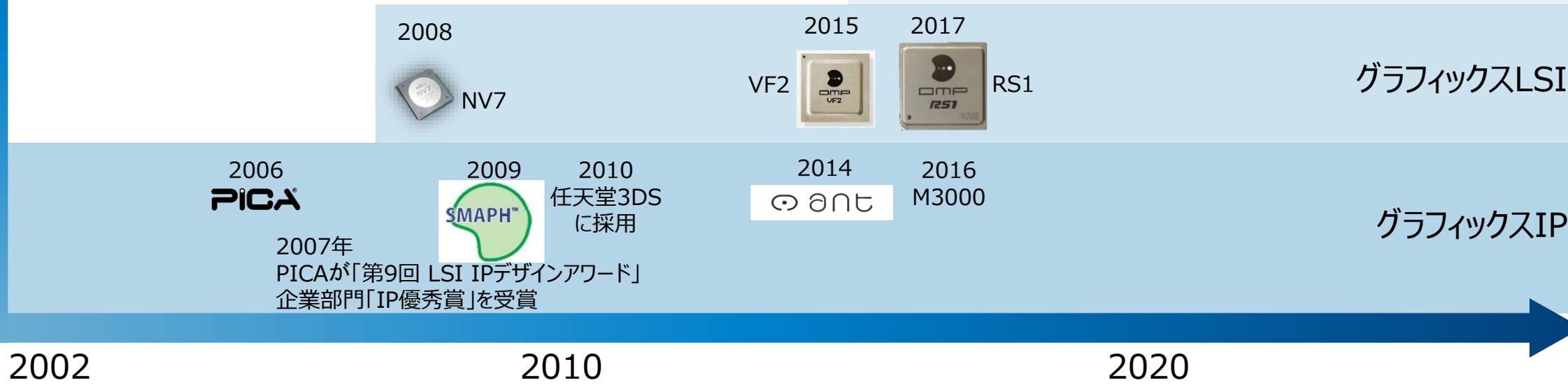
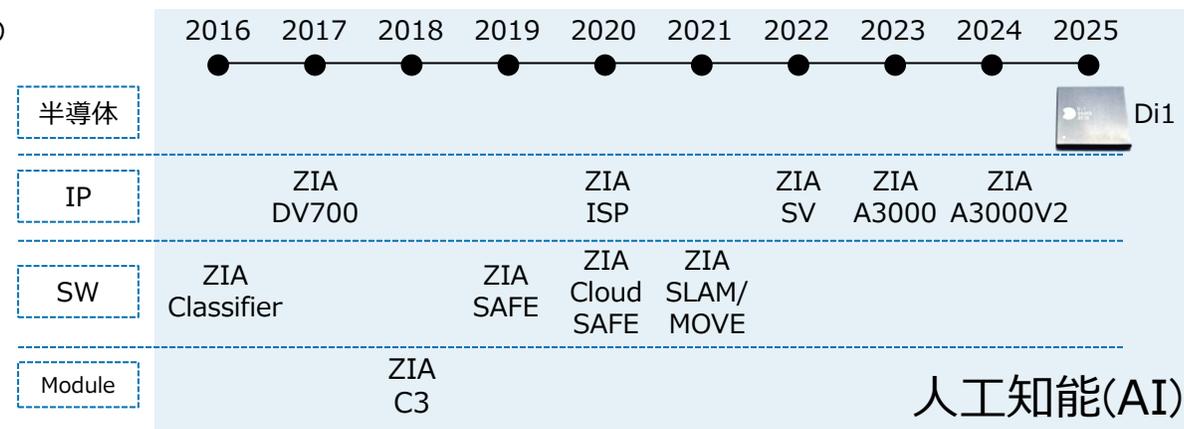
開発人材の強化や品質、コスト、デリバリーのコントロールにより、開発競争力の強化、顧客満足度の向上、収益の改善を図る

# 収益向上のキーアクティビティ テクノロジーイノベーション

組み込みGPUパイオニアとしてAI、ビジュアルコンピューティング分野において蓄積してきた卓越した技術をベースに、尖ったハードウェア・ソフトウェアIP、ソフトウェア、製品、サービスを開発・提供し続ける

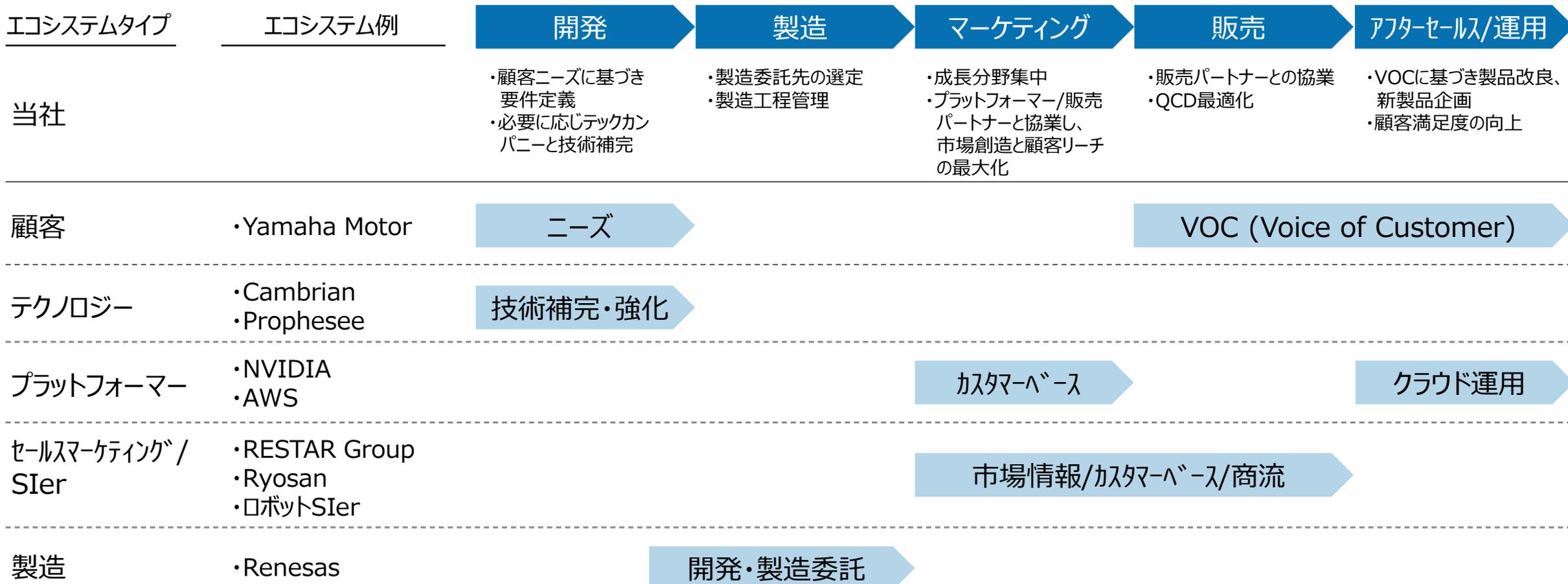
- 2002年に大学発ベンチャー企業として日本が持つCGプロセッサ技術のレベルの高さを世界に示すべく創業。世界有数のグラフィックスIPベンダーとして省電力、小型、高グラフィックス性能のIPを開発・提供
- 自社のグラフィックスIP技術を組み込んだ高性能のグラフィックスLSIを開発
- 2016年、創業来蓄積してきたGPU技術をベースに、AI・ディープラーニングに対する知見を融合したソフトウェア、ハードウェア、サービスで構成されるプラットフォーム「ZIA」を開発、AI分野に進出
- エッジ環境でも動作可能な生成AIを実用化
- 次世代エッジAI半導体「Di1」を開発中

テクノロジーの幅



# 収益向上のキーアクティビティ 顧客/エコシステムマネジメント

顧客を含めた各種エコシステムとの関係性向上や協業活性化により、顧客維持・獲得、テクノロジー補完・強化を図る



当社の強みである「半導体」技術をてこに、セーフティ・ロボティクス分野及びその応用・融合分野を深耕する

## エッジAI半導体

## セーフティ

## ロボティクス

## アミューズメント

中期事業戦略  
への生かし  
(前回資料)

- モデルベース開発対応により、自動車に加え、建機、農機分野等を攻略
- 高精度なAI認識技術を活用したスマートシティ、スマートビル等の広範なセーフティ市場の攻略
- 生成AIの活用、軽量化

- 自律走行ロボット向けライセンス供与から量産ライセンス獲得活動は継続
- Cambrianビジョンシステムは顧客インラインへの複数導入を加速
- 技術/製品/顧客シナジーが見込めるFA検査市場に参入

- 顧客ベースの拡大
- 周辺機器への製品検討・導入

セーフティ、ロボティクス技術の融合により、市場成長が期待できる映像点検分野、半導体製造装置分野等を攻略

成果と  
新たな取り組み

- FP4/ViT対応 4TOPS NPU、Stereo Visionアクセラレータ、2D GPUレンダリングエンジン、4K HDR ISP等をワンチップ化した次世代エッジAI推論チップ「Di1」を開発
- 2026年3月期第4四半期出荷開始

- 生成AI（LLM：大規模言語モデル）技術を活用した迷惑スケートボードの検知システムを開発、商用化
- 建設重機「バックホウ」のアームが架空線や障害物等に接触する事故の防止に、ステレオビジョンIP「ZIA SV」を活用した屋外実証実験実施

- 食品工場向け最新AMR2機種に「ZIA MOVE」が採用
- Cambrianビジョンシステムは自動車製造業の顧客インラインへの複数導入を実現
- 中国先進企業と代理店契約締結  
AMRユニット、コンポーネント、ソフトウェアを総合的に提供するFA事業を開始

- 「RS1」搭載のZEEG社業界標準筐体で業界シェア拡大中
- 周辺ビジネスの取り込みによる付加価値増大とコスト低減などによる利益の強化を図る

「Di1」をセキュリティカメラ、車載機器、スマートファクトリー、ドローン、AMR/ロボティクス、インタラクティブ端末等向けに拡販することで、セーフティ・ロボティクス分野及びその応用・融合分野を深耕。社会課題の解決に貢献

- モデルベース開発※<sup>1</sup> (RTMaps) に対応させたZIA SAFEやZIA SVにより、自動車、建機、農機分野等を攻略
- より広範なセーフティ領域であるスマートシティ関連等に事業拡張
- 生成AI (LLM:大規模言語モデル) 技術を活用した先進安全システムの研究、実用化 (迷惑スケートボーダー検知)

**ZIA™ SAFE**

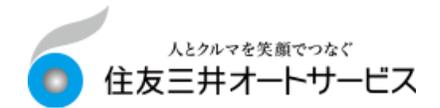
**エッジAI(推論)**

- ・リアルタイム認識
- ・プライバシー、セキュリティ
- ・送信データ量削減




車外・車内 (ドライバー) 監視

**JVCKENWOOD**  
**DENSO TEN**



**ZIA™ Cloud SAFE**

**SaaS型クラウドAI (推論&学習)**

- ・API提供
- ・拡張性
- ・高精度認識
- ・24/7運用
- ・継続学習



公共安全    スマートシティ    BEMS※<sup>2</sup>

地方自治体  
エネルギー  
ビル・建設

※<sup>1</sup> システムを構築する制御や制御対象をモデル化し、シミュレーションすることで、検証を行いながら設計開発を進めていく手法  
設計工程での検証が可能となり、検証工程における手戻りが少なくなることで、開発工数の大幅な短縮と品質向上が可能となる

※<sup>2</sup> Building Energy Management Systemの略。ビル内で使用する電力の使用量などを計測し、「見える化」を図るとともに、空調や照明設備等を制御するエネルギー管理システム

- 環境変動に強いVisual SLAMをベースに自律運転のフルパイプラインを実現 (ZIA MOVE)
- 中国リーディング企業のAMR/AGVユニット、コンポーネント、ソフトウェアの取り扱い開始、顧客の課題解決に即応
- ピッキングロボットの目の役割を果たすCambrianビジョンシステムは、外乱光に対するロバスト性、光沢・透明物等の高難易度ピッキング能力をてこに、顧客の組み立てラインへの複数導入を加速
- 高機能・カスタム製品、オフ・ザ・シェルフ製品、特定用途製品の包括的ラインナップにより、顧客のニーズにワンストップ対応

## 高機能・カスタム



ZIA MOVE

## オフ・ザ・シェルフ



AMRユニット・  
コンポーネント

## 特定用途



Cambrian  
ビジョンシステム



製造業



運輸・物流業



建設業



農業

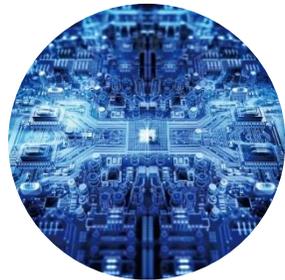


AMR/AGV  
開発メーカー

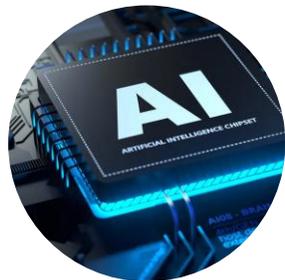
- リアルタイム3Dエンジンと高性能・高圧縮動画エンジンをワンチップ化（業界初）  
美しい映像表現と遊技機筐体コスト削減を両立
- 堅調なパチスロ市場とRS1を搭載したZEEG製標準筐体の遊技機業界への浸透に伴うシェア拡大
- 当社のユニークな2D・3D統合チップの優位性を発揮できる市場セグメントにおけるシェア拡大、新規顧客参入を目指す
- 周辺ビジネスの取り込みによる付加価値増大とコスト低減などによる利益強化を目指す



- お客様のデジタル機器のアプリケーション、搭載SoCに最適な小サイズ、低消費電力、高性能なIPを開発・提供
- デジカメ、OA機器、テレビ、監視カメラ等幅広い顧客／アプリケーション向けランニングロイヤリティの安定獲得



GPU IP



AI IP



RENESAS

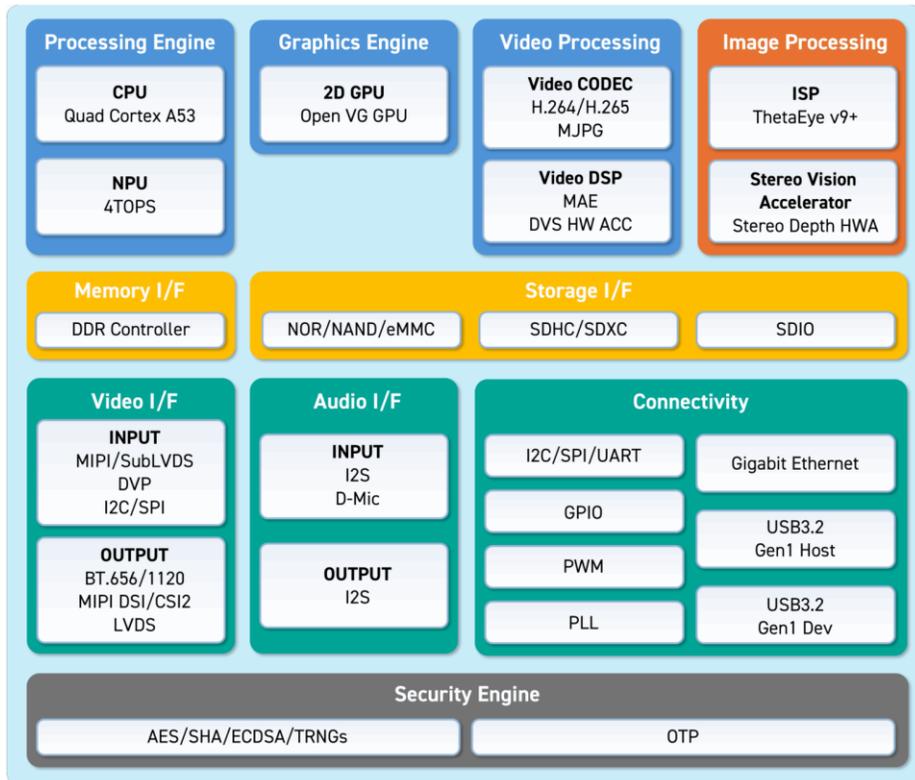
FUJIFILM  
Value from Innovation

OM SYSTEM

REGZA

# 注力分野個別戦略 次世代エッジAI半導体

- 高度な機能統合により次世代エッジAIを実現するAll-In-Oneインテリジェントビジョンチップ
- リアルタイム3D測距、iCatch製高画質ISP、高性能AI（FP4への対応等）の組み合わせにより、ドローンやロボティクスなどに要求される3D空間における高度な視覚認識やAI処理を実現
- アプリケーション：セキュリティカメラ、車載機器、スマートファクトリー、ドローン、AMR/ロボティクス、インタラクティブ端末等



## ● KPI

- セーフティ分野、ロボティクス分野及び両分野の融合領域、並びにその他分野（デジタル機器向けIP）売上高
- サステナビリティのKPIと平仄を合わせ、注力分野であるロボティクス分野およびセーフティ分野において、少子高齢化による労働人口不足の克服、安心安全社会の実現といった持続可能な社会の実現に資する製品・サービスの創造・提供、また、IPコアライセンス事業において、低炭素社会の実現に資する製品・サービスの創造、提供を進める

## ● KPI推移

(百万円)	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
セーフティ	49	163	170	71	38
ロボティクス	166	236	185	168	168
その他分野	148	111	144	134	90
売上高	363	512	500	374	298

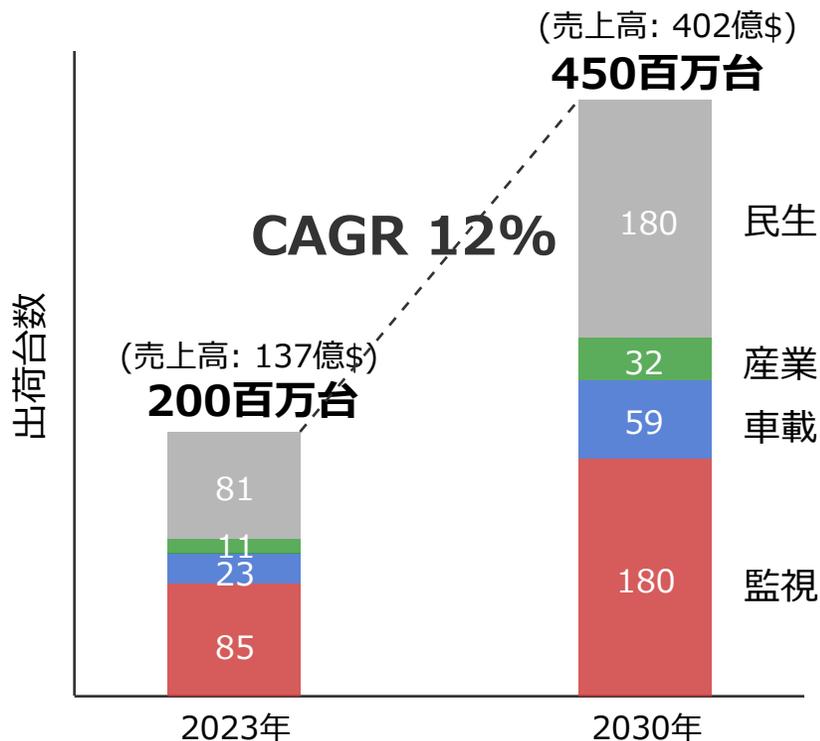
2025年3月期は、主にセーフティ分野においてドライブレコーダー関連の新規案件が少なかったこと、並びにその他分野において前年度の大型メンテナンスサポート案件が剥落したことにより、前年度実績を下回った

## ● KPI向上施策

省電力性能に優れた次世代エッジAI半導体をてこに、セーフティ分野・ロボティクス分野、その融合領域に付加価値の高い差異化された製品やサービスの創出、提供を行い、売上高の成長を図る

- 監視、車載、産業3分野だけでも2030年に2億7千万台のマーケットポテンシャル
- 競合製品比、圧倒的な電力・性能優位性
- リアルタイム3D測距、高画質ISP、高性能AI等高度な機能を統合したAll-in-Oneインテリジェントチップを国内外市場に投入し、**2030年3月期に30億円規模**の売上達成を目指す（3分野の1%未満のシェアで達成可能）

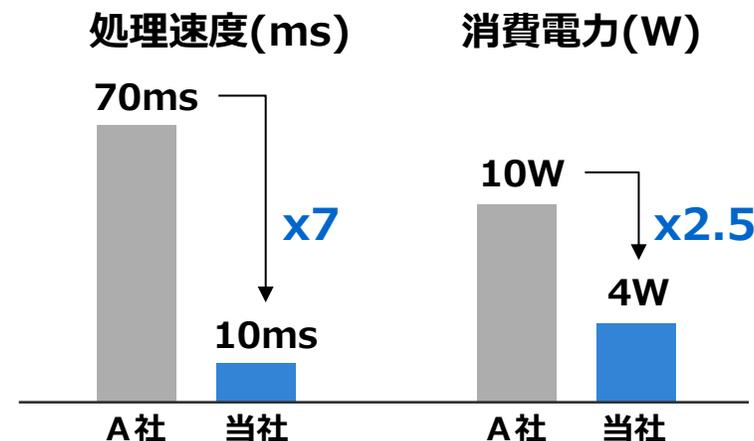
## 世界エッジAIカメラ市場



## 競合性能・消費電力比較 (ステレオビジョン機能)

\*台湾ドローンメーカーでの同条件の計測結果

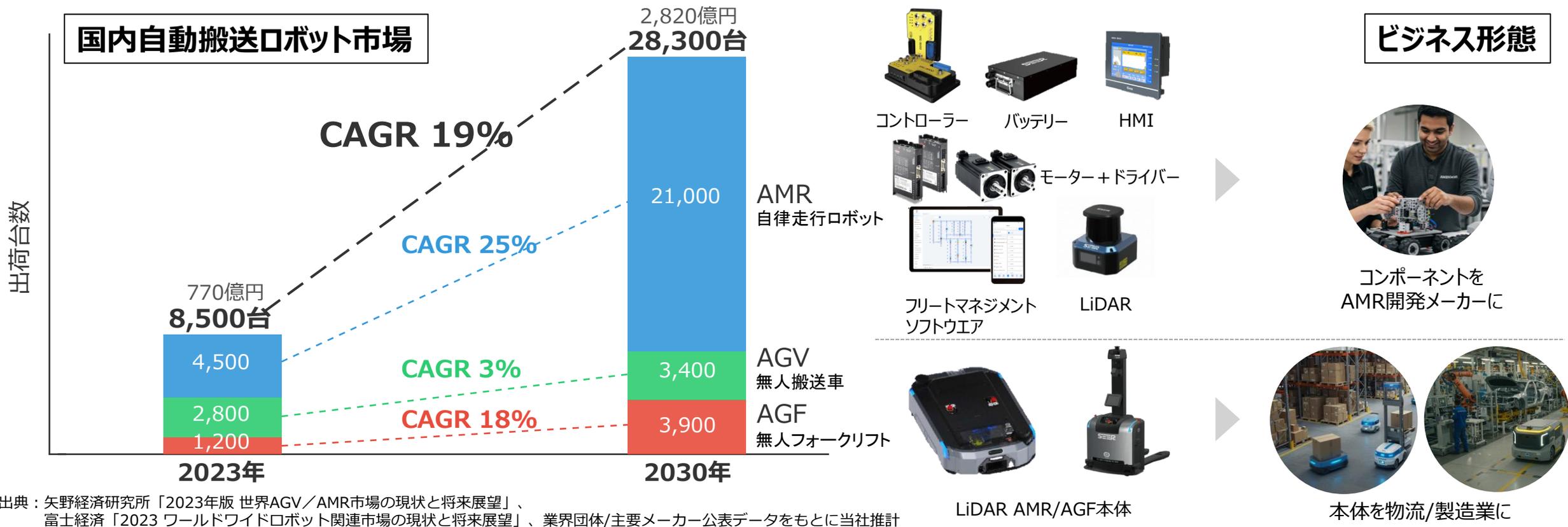
## 17.5倍の電力・性能効率



出典：MarketsandMarkets “AI Camera Market by Type - Global Forecast to 2030” (July, 2023)をもとに当社推計

# 中期ビジョン (FA事業)

- 労働人口不足対応、製造/物流DX加速により、自動搬送ロボットの出荷台数は年率19%で成長（内製AMRを加えた拡張市場規模はこの2倍以上 [当社業界ヒアリングによる]）
- 中国先進企業の包括的な製品ラインナップにより、AMR/AGFコンポーネントはAMR開発メーカーを、本体は物流/製造業をターゲットに、**2030年3月期に20億円規模**の売上達成を目指す（拡張市場の2%未満のシェアで達成可能）



## 成長分野への展開：エッジAI半導体事業

コア事業で培った強み、ノウハウを活かした、新たな分野での半導体ビジネスを展開  
モビリティ、スマートファクトリー、ドローン、スマートカメラなどの高成長市場で採用拡大

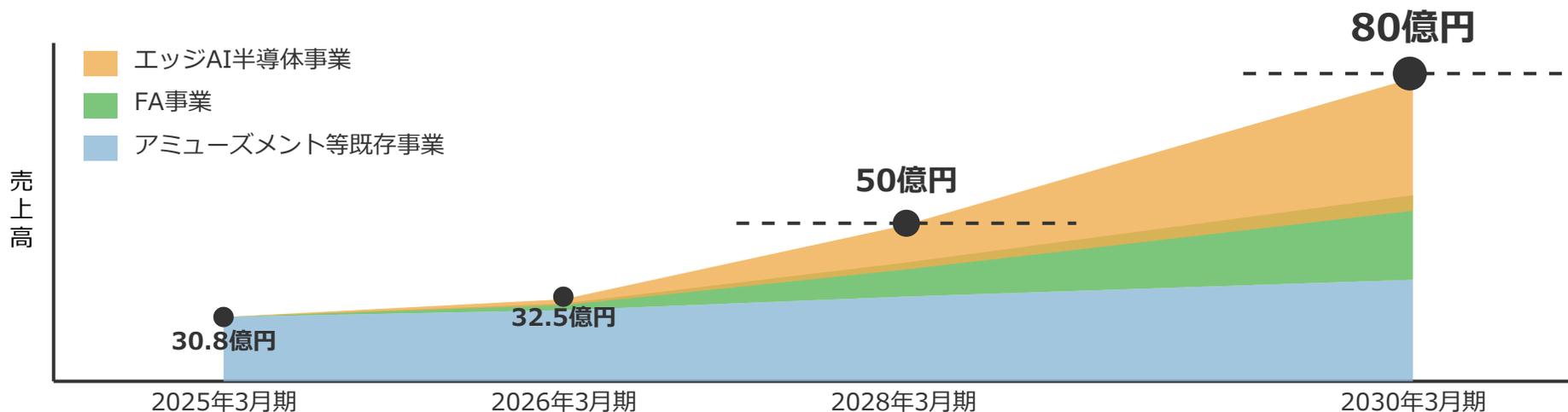
中長期的な  
企業価値向上

## 新規事業機会の獲得：FA事業

当社の更なる成長実現のため、新事業領域に取り組む Cambrian Vision Systemで築いた業界ネットワークを生かし、ロボティクス、ファクトリーオートメーション、物流自動化のさらなるスマート化により、日本の社会課題解決に貢献

## コア事業の更なる成長：アミューズメント事業

周辺ビジネスの取り込みによる付加価値増大とコスト低減などによる利益の強化



# リスク情報



項目	主要なリスク	顕在化の可能性/時期	影響度	リスク対応策
技術の陳腐化や研究開発の失敗	グラフィックス処理やAIの技術は進化の速度が非常に速く、当社が後れを取ってしまうリスクがあります。また、研究開発が遅延したり頓挫したりするリスクもございます。	中/不明	大	技術動向を注視し、積極的に技術開発を進めていきます。また、技術開発に必要な優秀な技術者の確保に努めてまいります。
販売先の市場動向	当社収益は、当社製品を組み込んだ顧客のアミューズメント機器や車載機器などの出荷台数と一部連動するため、これら製品の販売が不振になった場合や法規制などによって出荷台数が減少した場合に減収となるリスクがございます。	小～大/不明	大	外部情報や顧客からの情報収集を行い、新市場の開拓や新製品の開発を積極的に進めてまいります。法規制については、当社単独で対処することは不可能ですが、チャネルや最終顧客と密接に連携し、当社業績への影響度を見極めるとともに、必要に応じて開示を行うなどの対応を行います。
人材の確保・育成	優秀な人材の確保が今後の成長の大前提ですが、AIをはじめとした先端技術人材の確保は難易度を増しています。人材確保がかなわなかった場合には、成長が阻害されるリスクがございます。	中/中長期	大	裁量労働制の導入といった柔軟な勤務体系や、株式報酬制度などの魅力的な報酬体系を用意して人材獲得に尽力しております。

※ その他のリスクにつきましては、有価証券報告書の「事業等のリスク」をご参照ください。

- 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ環境や当社の関連する業界動向等により変動することがあります。従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されている将来の見通しに関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください。
- 本資料は、弊社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり、弊社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。本資料に全面的に依拠した投資等の判断は差し控え願います。
- 「事業計画及び成長可能性に関する事項」の進捗状況を含む最新の状況につきましては、本決算発表後6月頃に開示を行う予定です。次回は、2026年6月頃を予定しております。

# 補足資料



事業	事業内容	主要顧客
IPコア※1 ライセンス事業	<p>精細画像の描画やディープラーニング（深層学習）※2などの人工知能（AI）※3に必要なハードウェアIP（論理設計データ等）やソフトウェアIP（主にハードウェアを制御するドライバーやコンテンツ制作を支援するツール類）の開発、ライセンス（使用許諾）供与</p> <p>a) ライセンス収入：顧客が製品開発を進める過程で、当社がIPコアライセンスのライセンスを与えたことによる対価</p> <p>b) リカーリング収入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ランニングロイヤリティ収入：IP組み込み製品を顧客が販売する際、製品出荷個数に応じて顧客から収受する対価</li> <li>・サブスクリプションフィー：顧客の当社サービスの使用実績等に応じて顧客から収受する対価</li> </ul> <p>c) 保守サービス：保守契約に基づくIPコアの保守等</p>	半導体メーカー 半導体が組み込まれた最終製品メーカー
製品事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グラフィックス LSI※4(SoC※5)(主にアミューズメント機器向け)の開発・製造・販売（製造は委託）</li> <li>・協働ロボット※6向けビジョンシステム（カメラによる物体認識システム）の販売 等</li> <li>・AI LSI・FPGA※7/モジュール(AIを使用する機器向け)の開発・製造・販売（製造は委託）等</li> </ul>	商社/SIer 半導体が組み込まれた最終製品メーカー
プロフェッショナル サービス事業	当社の各種IPコアをインテグレーションしてSoCシステム全体を検討・最適化する設計サービス、自社製品の開発により培ったGPU※8/ビジョン/AI技術等をベースにしたアルゴリズム開発や最適化を行なうソフトウェア/ハードウェアサービス等さまざまなサービスを提供	半導体が組み込まれた最終製品メーカー

※1: LSIを構成するための部分的な回路情報のうち、特に単一機能でまとめられたもの（例：グラフィックスIPコア）。IPはIntellectual Propertyの略称

※2: 画像認識分野などで実用化が進む、人工知能を実現する機械学習の手法の一種。人間の脳を模したニューラルネットワークの仕組みを活用

※3: 人間が行っている認知や判断を、コンピュータを使って行うためのソフトウェアやシステムのこと。文章、画像、会話、音などを理解し判断するコンピュータプログラムなど

※4: シリコンウエハ（半導体製品の製造に使用される導体と絶縁体の中間の性質を持つ物質）で形成される大規模集積回路。Large Scale Integrationの略称であり、「半導体」とも呼ばれる

※5: 一つの半導体チップ上に必要とされる一連の機能（システム）を集積する集積回路（の設計手法）。System on a Chipの略称

※6: 安全柵なしで人と共同作業ができるロボット

※7: 製造後に購入者や設計者が構成を設定・変更できる集積回路。Field Programmable Gate Arrayの略称

※8: コンピュータゲームに代表されるリアルタイム画像処理に特化した演算装置ないしプロセッサ。Graphics Processing Unitの略称。CPUよりも並列演算性能にすぐれた特性を生かし、その演算資源を画像処理以外の目的に応用する技術（GPGPU: General-Purpose computing on GPU）がAI・ディープラーニング分野に活用されている



## 2026年3月期は将来の成長に向けた攻めの戦略的投資を実行

(単位：百万円)	2025年3月期 通期実績	2026年3月期	
		通期予想	増減率
売上高	3,077	<b>3,250</b>	+5.6%
営業利益	265	<b>20</b>	△92.5%
経常利益	271	<b>25</b>	△90.8%
親会社株主に帰属 する当期純利益	157	<b>20</b>	△87.3%

- 堅調なアミューズメント向け画像処理半導体出荷に加え、新規事業である次世代エッジAI半導体事業およびFA事業の売上も限定的ながら貢献し、売上高は増収を見込む
- 次世代エッジAI半導体開発（開発費US\$190万ドル）を中心に将来の成長に向けた戦略的投資を実行
- 中期的には、アミューズメント市場の更なる取り込みに加え、エッジAI半導体事業とFA事業の2本の成長エンジンにより、収益拡大、企業価値向上を目指す